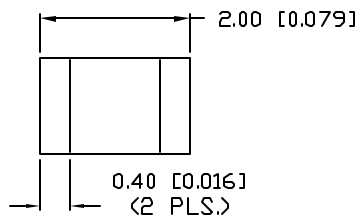
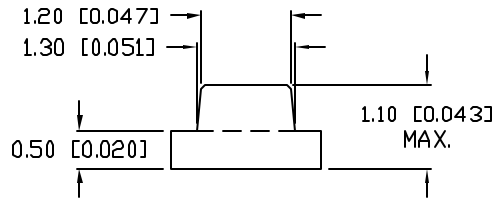
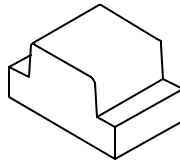
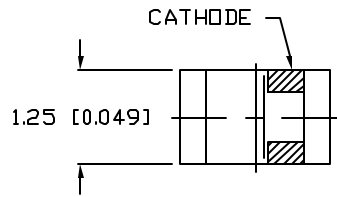


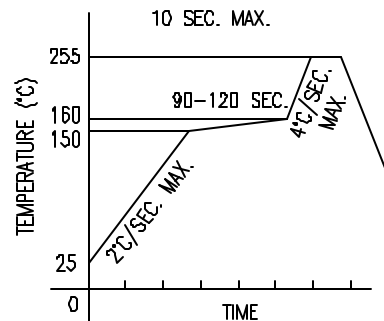
UNCONTROLLED DOCUMENT

PART NUMBER		REV.
SML-LXF0805YD-TR		B

REV.	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE
A	E.C.N. #10967.	3.14.03
B	E.C.N. #11148.	2.14.05



LEAD FREE REFLOW PROFILE



TOTAL TIME ABOVE 220°C IS 60 SECONDS MAX.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^\circ\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		585		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.1	2.5	V_f	
REVERSE VOLTAGE	5.0			V_r	$I_f=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		8		mod	$I_f=20\text{mA}$
VIEWING ANGLE		120		$2x$ theta	
EMITTED COLOR:	YELLOW				
EPOXY LENS FINISH:	YELLOW DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	140	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	105	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/°C
OPERATING TEMP.	-30 TO +85	°C
STORAGE TEMP.	-40 TO +85	°C

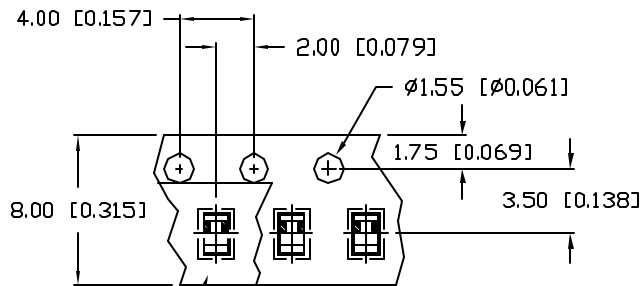
* $t < 10\mu\text{s}$

NOTES:

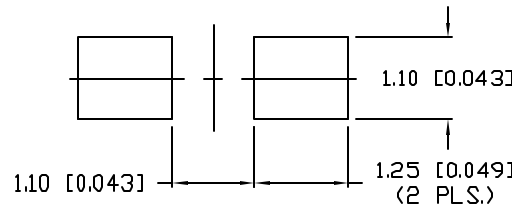
- THE POLARITY MARK IS ORIENTED TOWARDS THE TAPE SPROCKET HOLE.



CAUTION: MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 4 STANDARDS



RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT



TOP TAPE
TAPE FEED DIRECTION

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.=^{+DECIMAL PRECISION}-0.00 MAX.=^{+0.00}-DECIMAL PRECISION

UNCONTROLLED DOCUMENT

REV.	PART NUMBER
B	SML-LXF0805YD-TR

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC, THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
US WEB: www.lumex.com
TW WEB: www.lumex.com.tw

2.0mm x 1.25mm SURFACE MOUNT LED,
585nm YELLOW LED
YELLOW DIFFUSED LENS, TAPE AND REEL.

RELIABILITY NOTE
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: 4.11.02
GB			PAGE: 1 OF 1
			SCALE: N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9